

信頼性試験結果 Reliability Test

XC61Gシリーズ

XC61G Series

パッケージ
Package

USP-3

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=10.8V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	125°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=10.8V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-55°C~125°C 各30分 30min Each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカー UHAIST	125°C85%RH 2×10 ⁵ Pa	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times →85°C85%RH24h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)1time Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020D		0/22
7	静電耐圧 Electric Static Discharge.	R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回 ±200V over 3times Each		0/20
		R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回 ±1kV over 3times Each		
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 ±100V over 3times Each		0/5
		50mA以上 50mA over		

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	接合強度試験 Adhesive strength test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回/1times (EIAJ ED4702) Strain	0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 10s (Temperature profile method)	0/11